

宏昌电子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 15 日 (周二) 下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董秘 陈义华
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 一、董秘好，请问公司 GBF 增层膜产线建设进度如何，年底能否进入试生产。在下游测试认证过程中，是否有良好进展！谢谢！ 尊敬的投资者 您好！ 1、2025 年 2 月，公司全资子公司珠海宏昌取得珠海经济技术开发区经济发展局“半导体级功能性树脂膜材研发及产业化项目”备案，2026 年 7 月 20 日并更新备案。 ①本项目投资：823.59 万美元（折合人民币 6 千万元）； ②项目建设规模及内容：在珠海宏昌二期项目建筑物内，新增生产设备，生产半导体级功能性树脂膜材，主要产品为 ABF 载板用增层膜材，主要应用于 ABF 载板，年产量 172.8 万平方米。本项目尚在建设中。

2、2026 年 9 月 11 日，公司披露《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，拟投资 3.3 亿人民币，新建“先进封装膜材（GBF）项目”生产线。截至目前，本项目所涉及环评及备案等手续正在办理中，项目建设需新增用地，相关土地使用权正在获取中。

3、上述项目具体情况，请见公司于上交所网站公开披露相关公告。上述项目建设过程中存在各种不确定因素，可能面临各种技术难题，导致项目无法顺利实施，或建设资金筹措不到位等，导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

二、贵公司的 gbf 膜生产线安装到什么程度了？什么时候能够量产？

尊敬的投资者 您好！公司相关 GBF 膜生产线尚在建设中，项目具体情况，请关注公司于上交所网站公开披露相关公告。感谢您的关注！

三、这次预告的定增，是用于什么项目、产品是什么？项目建设期多久、何时形成生产能力？预计年销售额和利润分别是多少？

尊敬的投资者 您好！

2026 年 9 月 11 日，公司披露《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，建设项目分别为：

1、珠海宏仁年产 1,320 万张高端覆铜板、3,120 万米半固化片建设项目；

2、无锡宏仁年产高端半固化片 960 万米智能化绿色化提升改造项目；

3、先进封装膜材（GBF）项目；

截至目前，上述项目所涉及环评及备案等手续正在办理中，相关建设需新增用地，相关土地使用权正在获取中。

	项目具体情况，请关注公司于上交所网站公开披露相关公告。谢谢您的关注！ 四、请问 GBF 验证进展到什么程度了？谢谢 尊敬的投资者 您好！ 公司开发 GBF 增层膜相关新材料，与下游客户需求配合，持续推进产品的系列化和产业化，推动产品在下游及终端客户的认证与应用。谢谢您的关注！ 五、半年报中显示，贵公司的 m6.m7 等产品可用于 1.6g 光模块，但还有一定瑕疵，比如良率等，然后进行优化，那现在过去 2 个多月了，这个优化到了什么程度？是不是已经可以完全满足光模块的用料要求了？ 尊敬的投资者 您好！ 公司与下游客户需求配合，持续优化推动相关产品在下游的应用与使用。谢谢您的关注！ 六、请问下贵公司在未来 AI PCB 产业链有具体实施方向或规划没？有的话可以和投资者交流下吗？ 尊敬的投资者 您好！ 公司实时关注行业的发展，目前公司 GA-686 系列高速覆铜板产品有通过 AMD、Intel 等相关测试认证，在电性及信赖性方面满足下游相关产品要求，公司与下游 PCB 及相关终端客户保持紧密联系，持续推广相关产品在下游的应用。 谢谢您的关注！
附件清单(如有)	
日期	2026-09-15 17:04:32